

NEWS RELEASE

**重点事業分野である電子材料事業の成長を加速
米国の半導体材料メーカーEntegris社の
半導体用プロセスケミカル事業を買収**

2023年5月10日

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、米国の半導体材料メーカーEntegris, Inc.（本社：米国マサチューセッツ州 以下、Entegris社）の半導体用プロセスケミカル事業を買収します。

当社は、5月10日、Entegris社のグループ会社で半導体用プロセスケミカル事業をグローバルに展開するCMC Materials KMG Corporation（本社：米国テキサス州 以下、KMG社）の発行済全株式を取得する株式売買契約を締結^{※1}しました。今回の買収を通じて、製品ラインアップ拡充による顧客提案力の強化や、より強固なグローバル製造体制の構築などを図り、当社電子材料事業の成長を加速していきます。尚、KMG社の全株式取得に要する資金総額は、7億米ドル^{※2}です。

半導体用プロセスケミカルは、半導体製造の洗浄・乾燥工程で異物を除去したり、エッチング工程^{※3}にて金属や油脂などを取り除くために使用する化学薬品で、半導体製造プロセスの基幹製品です。現在、半導体の高性能化に伴って、半導体の微細化・多層化が進み、製造プロセスがより複雑化しています。このような中、半導体用プロセスケミカルの使用頻度が加速的に増え、その市場は年率11%^{※4}で成長しています。また、半導体用プロセスケミカルの性能では、ppb^{※5}レベルからさらに1ランク高いppt^{※6}レベルの高純度化が求められています。

KMG社は、高度な精製技術・品質管理ノウハウにより、pptレベルの高純度化を実現する半導体用プロセスケミカルを開発しグローバルに提供してきた実績を有する会社です。現在、米国・フランス・イタリア・シンガポールなどに全7カ所の製造拠点をもち、高純度な硫酸・イソプロピルアルコール（IPA）・水酸化アンモニウムなど幅広い半導体用プロセスケミカルを生産。米国・欧州・東南アジアで大手半導体メーカーなどの顧客基盤を構築し、グローバルに製品を供給しています。

当社は、フォトレジスト^{※7}やフォトリソ周辺材料、CMPスラリー^{※8}、ポストCMPクリーナー^{※9}、薄膜形成材^{※10}、ポリイミド^{※11}など半導体製造の前工程から後工程までのプロセス材料、イメージセンサー用カラーフィルター材料をはじめとしたWave Control Mosaic（WCM）^{※12}を展開しています。また、これらの幅広い製品のみならず、グローバルの安定供給体制、高い研究開発力、顧客との強固な信頼関係を強みに、積極的な設備投資などの成長戦略を進め、事業拡大を図っています。今回の買収を通じて、KMG社の幅広い半導体用プロセスケミカルを獲得。半導体製造プロセスを広くカバーする製品ラインアップで総合提案力を高め、顧客の製造プロセスの課題解決を図っていきます。また、欧米での製造拠点の拡充に加え、当社の半導体材料分野では初めてとなる東南アジアでの製造拠点の取得で、より強固でグローバルな製造体制を構築し、サプライチェーンの強靱化に貢献していきます。さらに、KMG社の高い精製技術と、当社が持つ、幅広い半導体材料を開発・製造できる高度な研究開発力・品質保証力などを組み合わせ、より高純度化した半導体用プロセスケミカルなど最先端

ニーズに対応した半導体材料を開発・提供することで、半導体のさらなる高性能化に寄与していきます。

当社は、今後も、中長期的な成長が見込まれる半導体市場に向けて、最先端の半導体材料を開発しワールドワイドに提供していくことで、電子材料事業をさらに拡大するとともに、半導体業界の発展に貢献していきます。

- ※1 当社と、Entegris社の子会社である CMC Materials LLCで締結しました。
- ※2 買収金額は、買収完了時点の対象会社の現預金、有利子負債及び運転資本等を考慮し確定するため、変動する可能性があります。尚、買収完了時期は、クローリング条件の充足を前提とし、2023年中を予定しています。
- ※3 シリコンウエハーに露光装置で回路を転写した後、化学薬品の腐食作用を利用して、不要な金属膜や酸化膜などを削り取って半導体回路を形成する工程。
- ※4 2021年から5年間の年平均成長率。米国調査会社「Linx」の半導体材料レポートより。
- ※5 parts per billion の略。不純物の割合が 10 億分の 1であることを表します。
- ※6 parts per trillion の略。不純物の割合が 1 兆分の 1であることを表します。
- ※7 半導体製造工程で、回路パターンの描画を行う際にウエハー上に塗布する感光性材料。
- ※8 硬さの異なる配線や絶縁膜が混在する半導体表面を均一に平坦化する研磨剤。
- ※9 CMP スラリーによる研磨後に、金属表面を保護しながら、粒子、微量金属および有機残留物を洗浄するクリーナー。
- ※10 低誘電率の絶縁膜を形成するための材料。
- ※11 高い耐熱性や絶縁性を持つ材料。半導体の保護膜や再配線層の形成に使用されます。
- ※12 広範囲な波長の電磁波(光)をコントロールする機能性材料群の総称。デジタルカメラやスマートフォンに用いられる CMOS センサーなどのイメージセンサーのカラーフィルターを製造するための着色感光材料を含みます。

【KMG社の概要】

1.	社名	CMC Materials KMG Corporation
2.	設立	1992年
3.	本社所在地	米国テキサス州フォートワース
4.	事業内容	半導体用プロセスケミカルなどの研究開発・製造・販売 トータルケミカルマネジメントシステム ^{※13} の提供
5.	従業員数	約560名

※13 化学薬品の物流や工場でのオペレーションなどをサポートするサービス。

本件に関するお問い合わせは下記にお願い致します

【報道関係】

富士フイルムホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ
TEL 03-6271-2000